



JASDAQ

2021年2月10日

各 位

会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 賀 賢 漢
(J A S D A Q ・ コード 6 8 9 0)
問 合 せ 先 執行役員 IR 室長 佐 藤 昭 広
(0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6)

特別損益の発生ならびに2021年3月期連結業績予想および期末配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、2021年3月期第3四半期連結会計期間において、下記のとおり特別損益を計上することとなりました。これを受けて、2020年11月13日に公表いたしました「2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」における2021年3月期の連結通期業績予想および期末配当予想につきまして、下記のとおり修正することといたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 特別利益の発生について

本日付「半導体ウエーハ事業子会社の特定子会社の異動に関するお知らせ」にてお伝えしましたとおり、当社の半導体ウエーハの子会社である杭州中欣晶圆半导体股份有限公司(以下、「FTHW」)の第三者への株式の一部譲渡および第三者割当増資により、当社グループのFTHWへの議決権比率が29.5%まで低下したことから、同社および同社の子会社2社を連結子会社から持分法適用関連会社に異動することとなりました。これを受けて、これまで株式一部譲渡による当社グループのFTHWの持分の減少額と売却価額との差額を資本剰余金として計上しておりましたが、2021年3月期第3四半期連結会計期間において、第三者割当増資による当社グループのFTHWの持分のみなし売却価額と連結貸借対照表上の帳簿価額の差額を特別利益の「持分変動利益」として計上することになったため、当該変動利益として約52億円の特別利益が発生することとなりました。なお、半導体ウエーハ事業は、当面営業利益ベースで赤字の計上が見込まれる中、今回のFTHWの持分法適用関連会社への異動により当社グループの営業利益・経常利益の底上げにも寄与していくものと考えます。

2. 特別損失の発生について

(1) 減損に至った理由

2021年3月期第3四半期連結会計期間において、太陽電池事業及びCVD-SiC事業に関する減損損失を特別損失に計上いたしました。太陽電池事業においては、構造改革により自社ブランドから撤退し、現在受託加工(OEM)のみとなっておりますが、今般当該事業の将来キャッシュ・フローを精査した結果、帳簿価額を回収可能価額まで減損することとなりました。また、2019年4月16日開示「韓国子会社におけるCVD-SiC事業からの撤退に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、韓国子会社による半導体製造装置向け消耗材であるCVD-SiC事業からの撤退にともない、遊休状態となっております建物及び機械装置などについて、現時点で将来の他の事業での使用の見通しが立っていないことから、今般回収可能価額まで減損することとなりました。

(2) 回収可能価額の算定方法

回収可能価額は、太陽電池事業については将来キャッシュ・フローを割り引いて算定した使用価値により、CVD-SiC事業については正味売却価額により測定しております。なお、正味売却価額は、他の転用や転売が困難であるものについては、零円としております。

(3) 減損損失の内容

対 象 会 社	上海申和热磁电子 有限公司	寧夏銀和新能源科技 有限公司	Ferrotec Advanced Materials Korea Corporation
対 象 事 業	太陽電池事業	太陽電池事業	CVD-SiC事業
用 途	シリコンウエーハの 受託生産	単結晶インゴットの 受託加工	CVD-SiC製造・販売
種 類	機械装置及び運搬具等	機械装置及び運搬具等	建物及び構築物、機械 装置及び運搬具等
場 所	中国上海市	中国銀川市	韓国忠清南道唐津市
減 損 損 失	約470百万円	約270百万円	約260百万円

3. 連結業績予想の修正

(1) 2021年3月期通期連結業績予想数値の修正 (2020年4月1日～2021年3月31日)

	売 上 高	営 業 利 益	経 常 利 益	親会社株主に 帰属する 当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前 回 予 想 (A)	85,000	6,500	5,500	1,500	40.41
今 回 予 想 (B)	89,000	9,000	8,000	7,000	188.37
増 減 額 (B - A)	4,000	2,500	2,500	5,500	
増 減 率 (%)	4.71	38.46	45.45	366.67	
(ご参考) 前期実績 (2020年3月期)	81,613	6,012	4,263	1,784	47.35

(2) 修正の理由

IoT、AI、5G等の情報通信技術の用途の世界的な拡がりに伴う旺盛な半導体需要や米中貿易摩擦による中国政府の半導体国産化政策の加速を背景に、半導体メーカーの高水準の設備稼働率や設備投資回復にともなう半導体製造装置市場の拡大基調の継続により、当社の半導体マテリアル製品の受注も堅調に推移しております。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が継続している中で、5G基地局の光通信用デバイス向けおよびPCR検査装置などの医療検査機器向けのサーモモジュール製品の需要も引き続き堅調に推移しております。

一方、上述の半導体ウエーハ事業3社の損益が持分法による投資損益に計上されることとなるため、主に利

益面において、前回公表時の通期連結業績予想より大幅に上振れする見通しです^(注)。以上から、子会社の業績進捗状況ならびに半導体ウエーハ子会社の持分法適用関連会社への異動による連結業績へ与えるインパクト（持分変動利益を含む）を考慮し、当連結会計年度の通期連結業績予想を上記のとおり修正します。なお、新型コロナウイルス感染症の収束時期拡大による事業活動への影響につきましては、引き続き「翌連結会計年度（2022年3月期）の一定期間に渡り継続する」との仮定を前提にしております。

(注) 持分法適用関連会社への異動による連結業績予想へ与えるインパクトについては下記のご参考を参照ください。

<ご参考> FTHWの持分法適用関連会社への異動による通期連結業績予想へのインパクト

	通期連結業績予想		
	a. 持分法適用関連会社へ異動した場合（今回）	b. 連結子会社を維持した場合	差額 (a-b)
売上高	百万円 89,000	百万円 91,000	百万円 △2,000
営業利益	9,000	7,500	+1,500
経常利益	8,000	6,500	+1,500
親会社株主帰属当期純利益	7,000	2,500	+4,500
減価償却費	9,000	10,000	△1,000

3. 期末配当予想の修正

	1株当たり配当金		
	第2四半期末	期末	合計
前回予想 (2020年11月13日発表)		円銭 12.00	円銭 24.00
今回修正予想		14.00	26.00
当期実績	12.00		
前期実績 (2020年3月期)	12.00	12.00	24.00

当社では、連結業績および配当性向等を総合的に勘案しながら、安定した利益還元継続を配当の基本方針としております。当期の配当金につきましては、子会社の業績進捗状況を鑑み、期末の配当金を1株あたり14.00円とし、年間の配当金を1株あたり26.00円とさせていただきます。

※予想数値は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しています。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。